

公司代码：600641

公司简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司
2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司拟向全体股东（上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本930,629,920股，扣除公司截至目前回购专户已持有的股份14,022,064股（公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配）后共916,607,856股，以此为基数计算，共计分配股利45,830,392.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.32%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中股份数发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万业企业	600641	中远发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周伟芳	杨怡忱
办公地址	上海市浦东新区浦明路1500号15层	上海市浦东新区浦明路1500号15层
电话	021-50367718	021-50367718
电子信箱	wyqy@600641.com.cn	wyqy@600641.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、行业发展态势与面临的机遇

（1）集成电路核心装备

当前全球新一轮的科技革命正在兴起，以 5G 通信、人工智能、物联网、云计算以及新能源汽车为代表的技术产业化应用，将推动产业变革加速演进。半导体产业作为新兴产业的核心支撑，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。2023 年，半导体行业整体处于周期下行—底部复苏阶段，根据 SEMI 发布的数据，预计 2024 年全球半导体制造业有望开启复苏，其中全球半导体设备规模有望达到 1053.1 亿美元，同比增长 4%，晶圆制造设备销售额有望达到 931.6 亿美元，

同比增长 3%。

集成电路设备作为贯穿半导体全产业链的技术先导者，是半导体产业发展的基础和关键支撑。近年来集成电路设备行业表现出较高的增长态势，但现阶段受下游晶圆厂以及存储器厂商产能利用率下滑，同时叠加高库存水平影响，产业的周期性调整趋势逐步传导至上游半导体设备行业。中商产业研究院分析，2023 年全球半导体硅片出货面积将达到 152.6 亿平方英寸。根据 SEMI 在 SEMICON Japan 2023 上发布的《年终总半导体设备预测报告》，预计半导体制造设备将在 2024 年恢复增长，在前端和后端市场的推动下，2025 年的销售额预计将达到 1240 亿美元的新高。

2023 年，我国集成电路产业发展外部环境愈发复杂，然而这也带来了前所未有的机遇，促进了半导体设备国产化率的提升。基于当前国际、国内市场现状以及技术发展趋势，半导体设备核心技术独立性和自主可控紧迫性愈加凸显，实现集成电路产业高质量发展，需要半导体设备厂商不断加强技术创新，推动设备向高精度化与高集成化方向发展，并逐步完善半导体产业链，最终实现上下游行业协同发展，共享共赢。

（2）房地产

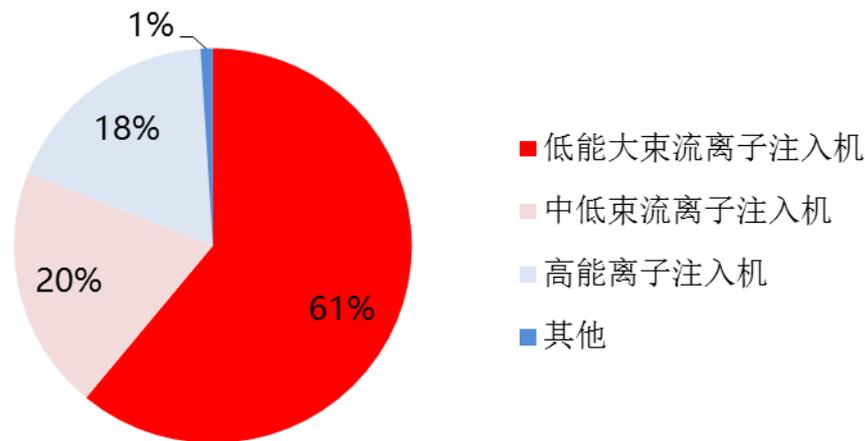
报告期内，中国房地产市场持续调整。据国家统计局数据显示，2023 年全国房地产开发投资 110913 亿元，同比下降 9.6%（按可比口径计算）。其中住宅投资 83820 亿元，下降 9.3%；商品房销售面积 111735 万平方米，同比下降 8.5%，其中住宅销售面积下降 8.2%。在政策调控方面，7 月 24 日中央政治局会议明确“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”后，8 月底以来，住建部等多部委出台了多项房地产优化政策，随后各地积极响应。根据中指监测，截至 2023 年 12 月 25 日，全国已有 200 余省市（县）出台房地产调控政策超 660 次，涉及公积金支持政策、发放购房补贴、优化限购、降低首付比例及房贷利率等方面，多数城市限制性政策完全放开。

2023 年，中央明确房地产行业支柱地位，中央及监管部门多次强调防范化解房地产风险，房地产风险主要体现在项目保交付、房企债务化解等方面。2023 年是“保交楼”的重要节点，年初央行提出新增 1500 亿元保交楼专项借款投放、设立 2000 亿元保交楼贷款支持计划、加大保交楼专项借款配套融资力度、强化保交楼司法保障等。8 月初央行明确将 2000 亿元保交楼贷款支持计划期限延长至 2024 年 5 月底。根据国家统计局数据，2023 年全国房屋竣工面积增长 17.0%，竣工面积明显增长得益于保交楼工作顺利推进，带动房地产开发项目竣工进度加快。化解项目交付风险仍是 2024 年政策重要发力点之一，预计“保交楼”配套资金和政策进一步落实，将进一步修复市场预期。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体设备市场主要由欧美、日本等国家的企业所占据，近年来我国半导体设备行业整体水平不断提高。

公司旗下凯世通是目前国内实现 28nm 低能离子注入工艺全覆盖的国产供应商，并率先完成高能离子注入机产线验证及验收，打破了国外技术壁垒。在离子注入设备众多机型中，低能大束流离子注入机是先进逻辑、存储芯片制造的关键核心设备，约占到离子注入机细分市场的 60%，中低束流和高能离子注入机分别占 20%和 18%。全球离子注入机市场主要由美国厂商占据，应用材料和亚舍立分别占比 70%和 20%。凯世通的核心产品——低能大束流离子注入机，在国内大型产线的综合表现对标基线机型，同时凯世通还在加速推进离子注入机设备的产品迭代与持续改进，构建全系列离子注入机产品线。



数据来源：Gartner

图：离子注入机分类市场份额

公司旗下嘉芯半导体已形成多个半导体前道核心设备产品线，业务覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多类主制程设备以及尾气处理等支撑制程设备，为汽车芯片、功率芯片、逻辑芯片等集成电路晶圆制造厂提供成套的前道设备解决方案。近年来嘉芯半导体持续布局成熟工艺的设备市场，在研发及生产集成电路核心前道设备方面不断拓展版图，伴随嘉芯半导体集成电路设备研发制造基地的落成，即以 109 亩土地 14 万方的新产能形成华东地区最重要的集成电路前道设备研发制造基地之一，帮助夯实公司“1+N”半导体设备产品平台化战略。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

纵观半导体行业的发展历史，虽然行业呈现明显的周期性波动，但整体增长趋势并未发生变化，而每一次技术变革是驱动行业持续增长的主要动力。在人工智能、电动汽车、新能源等新兴领域的快速发展拉动下，晶圆厂将持续进行资本开支，扩充产能，进而推动上游半导体设备行业的稳步增长。

在化合物半导体功率器件领域，随着新基建、“碳达峰、碳中和”的政策与规划密集推出，化合物半导体在清洁能源、新能源汽车及充电桩、功率器件快充、大数据中心等应用市场的需求已经开始呈现出快速增长趋势。

随着芯片制造工艺不断走向精密化，市场对于集成电路设备的性能提出了更高的技术要求。对离子注入而言，芯片设计的日益复杂，对离子注入机提出更高的技术要求，如高能量、高精度、高均匀度、低污染等，所需的离子注入工序亦相应增加。同时，芯片制程的升级也带来了新的掺杂需求，如 SOI、MEMS 等特殊工艺，这就需要开发新型的离子注入机来满足。

为了不断实现半导体设备工艺突破，公司将坚持高强度的研发投入，持续迭代升级、优化现有设备和工艺，力求不断推出面向未来发展需求的新工艺、新设备。

4、公司主营业务情况

公司主要从事集成电路核心装备的研发、生产、销售与技术服务以及房地产业务。

公司旗下凯世通和嘉芯半导体主要从事集成电路核心装备业务。凯世通所涉核心装备业务是以离子注入技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目，主要业务是研发、生产、销售国际领先的高端离子注入机，重点应用于半导体集成电路等领域，目前营业收入包括自研离子注入机、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务等。

嘉芯半导体所涉及的产品范围覆盖刻蚀机、薄膜沉积、快速热处理等多品类的半导体前道设备。公司聚焦于集成电路设备国产化的发展机会，致力于实现主流及成熟制程的核心设备及支撑设备本地化研发制造，为汽车芯片、功率芯片、逻辑芯片等集成电路晶圆制造厂提供成套的前道

设备解决方案。

公司房地产业务目前主要是存量房产的销售和经营，已无新的住宅开发项目。目前存量房地产业务范围主要集中在上海及长三角区域。

5、公司主要产品情况

公司持续布局半导体设备材料赛道，以多品类设备叠加离子注入机业务形成“1+N”产品平台模式，即从领先的全领域离子注入机全面扩展至更多品类的半导体前道核心设备产品线，业务覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多类主制程设备以及尾气处理等支撑制程设备。同时根据市场动态和客户需求，利用现金储备优势，围绕集成电路制造工艺拓展业务品类，在完善工艺链条的同时努力实现上下游产业链协同，推动平台产品矩阵的丰富完善及产业稳步延伸发展。



目前，公司产品主要应用于集成电路行业，公司的主要产品情况如下：

在晶圆制造过程中，要使纯净硅具有可控的导电能力（即成为半导体），就必须将一定数量的杂质离子掺入半导体材料中，以改变材料的表面成分、结构和电学特性，从而优化半导体材料的表面性能，提高其导电性。离子注入机通过对注入剂量、注入角度、注入深度、工艺温度等方面进行精确地控制，配合适当的掩膜材料，能在晶圆区域上特定位置注入离子，成为决定集成电路器件电学特性的关键装备。

离子注入机根据注入剂量与注入能量的差异，分为三大细分机型：低能大束流离子注入机、中束流离子注入机和高能离子注入。其中低能大束流离子注入机和高能离子注入机的技术难度更高。

公司旗下凯世通是国内领先的以离子注入技术为核心的集成电路高端装备企业，采用了通用平台+模块化的设计理念，基于正向设计和自主创新，攻关了长寿命离子源、高质量分析磁体、束流减速装置等关键技术模块，同时集成了自主研发的通用平台和软件控制系统，解决了极端低能量与大束流之间的矛盾，攻克了注入角度控制、颗粒污染控制等技术难题。经过多年持续的研发投入和技术积累，凯世通实现了低能大束流系列离子注入机和高能离子注入机产业化应用，工艺覆盖逻辑、存储、功率、图像传感器等多个应用领域。

主要产品	图示	应用领域
低能大束流离子注入机系列		
iStellar-500		产品主要应用于集成电路浅结及超浅结的掺杂工艺的注入。
iStellar-500C		产品主要应用于集成电路预非晶化注入工艺。
高能离子注入机系列		
iStellar-HE2000		产品主要应用于集成电路深阱掺杂工艺的注入。
CIS 离子注入机系列		
iStellar-500CIS		产品主要适用于 CIS 器件，具备金属污染控制、高精度注入角度控制等特点。

公司旗下嘉芯半导体致力于关键制程设备及支撑设备的本地化研发制造。

主要产品	图示	功能简介
<p>PHOEBUS PVD 系统</p>	 <p>The image shows the PHOEBUS PVD system components, including a large white cabinet and a blue base unit. Below the main image is a diagram illustrating the process flow: PM(Pre clean) → PM(PVD) → TM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PHOEBUS PVD 系统是一种全自动集群式 PVD（物理气相沉积）设计用于容纳多个沉积室的系统，能够精确控制过程并进行高水平通过创造超高真空（10E-8 torr）的环境并控制各种变量过程，采用真空溅射薄膜沉积工艺。 ● 应用于半导体 8 吋晶圆金属薄膜的沉积，通过离子轰击金属靶材，使其沿着一定方向脱落沉积于衬底上。例如 Al, Cu, Ti, TiN, Ta 等金属薄膜工艺。 ● 其主要结构包含 4 个 PVD 工艺腔体(PM)，2 个 Pre clean 腔体（PM），以及传输模块（TM），其中 Pre clean 腔体可根据客户需求更改为 PVD 腔体或刻蚀等其他工艺腔体。其主流的工艺腔体对接设计，可以增加用户选择的灵活性，可根据工艺需求来选择不同配置的腔体。

此外，嘉芯半导体基于客户特殊工艺的需求，耗时 6~12 个月开发深槽刻蚀工艺，将每个线宽的沟槽做到业界高标，并且长期重复性试验，进而达到工艺要求，符合客户的实际需求。

6、主要经营模式

（1）盈利模式

公司主要从事集成电路设备的研发、生产和销售，以及存量房产的销售。其中专用设备制造业务，公司通过向下游客户销售设备、提供配件及技术支持服务来实现收入和利润；房地产业务，公司坚持深化转型，加速存量房产去化，实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于存量房产销售交付和集成电路设备、相关零部件销售以及设备支持技术服务等。

（2）研发模式

公司秉承自主创新的研发理念，以满足客户制造需求和业界前沿技术发展为导向，采用“领先一步”的差异化竞争策略，坚持正向开发的理念，从“第一性原理”出发，依托“通用平台+关键技术模块”的开发模式，依靠具有扎实理论基础与丰富实践经验的研发团队，快速开发产品并迭代，并在全球主要集成电路芯片生产国家及地区申请专利保护，将技术成果迅速产业化，已取得一系列的技术创新和突破，在国内重要芯片产线率先完成验证及产业化应用，不断拓展服务

用户。此外，公司已建成一支由国内外资深半导体技术与运营管理专家引领的有梯队、有层次的研发团队，成员专业知识与工程经验储备深厚，是公司自主创新与产业化能力的基石。同时，公司会根据客户不同的工艺应用需求，持续完善量产产品功能。未来公司将继续吸引产业内的优秀人才，充实业界一流的公司研发团队，为客户提供满足技术要求的设备与工艺解决方案。

（3）采购模式

为保障公司产品质量和性能，公司建立了完善的采购体系，在报告期内进一步优化了供应链资源、供应商准入体系和零部件供应策略。持续更新并定期审核供应商档案，了解供应商的人员情况、生产能力、设计能力、财务情况、关键零部件供应商情况、生产和检测设备情况等，对供应商的产品技术与质量、按时交货能力和售后服务等进行综合评估，最终确定合格供应商，纳入合格供应商名单。为保障零部件的质量和性能，公司按月度统计交付合格率并反馈给供应商以改进提升质量，提升进料合格率。报告期内，公司与主要供应商保持长期、稳定的合作关系。

（4）生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，根据客户需求，以订单式生产为主，结合少量库存生产为辅的生产方式。订单式生产是指公司在与客户签订订单后，根据订单情况进行定制化设计及生产制造，以应对客户的差异化需求。库存式生产是指公司对设备通用组件或成批量出货设备常用组件根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。

（5）销售模式

公司集成电路业务采取直销为主的销售模式，通过主动客户拜访、商业洽谈、行业展会、业内交流、政府或相关机构引荐，以及用户推荐、招投标等方式获取客户订单。公司采取“高端应用引领”的市场开拓策略，经过多年的研发积累与技术耕耘，关键技术模块在国际龙头企业的芯片制造线取得技术认可，树立了公司的市场声誉和专业实力，进而持续开拓国内晶圆厂头部客户。

公司的销售流程一般包括市场调查与推介、获取客户需求及公司内部讨论、产品报价、投标操作与管理（如适用）、技术需求沟通和销售洽谈、合同评审、销售订单（或 Demo 订单）签订与执行、产品安装调试、合同回款、客户验收及售后服务等步骤。经过多年的努力，公司已与多家半导体行业龙头企业形成了较为紧密的合作关系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	10,586,225,576.26	9,762,173,591.65	8.44	9,166,819,576.39
归属于上市公司股东的净资产	8,365,477,483.22	8,313,021,289.13	0.63	7,615,259,204.24
营业收入	964,609,315.55	1,157,576,095.64	-16.67	879,907,256.74
归属于上市公司股东的净利润	151,149,591.48	423,579,000.18	-64.32	376,516,114.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,328,961.86	320,146,548.68	-75.85	233,223,792.60
经营活动产生的现金流量净额	-240,540,114.25	-670,573,638.93	不适用	358,924,004.02
加权平均净资产收益率（%）	1.80	5.29	减少3.49个百分点	5.34
基本每股收益（元/股）	0.1624	0.4552	-64.32	0.4135
稀释每股收益（元/股）	0.1624	0.4552	-64.32	0.4135

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	124,279,274.34	264,984,468.57	372,617,028.45	202,728,544.19
归属于上市公司股东的净利润	80,322,179.80	38,278,083.14	45,006,872.94	-12,457,544.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,728,325.59	11,990,645.44	38,221,265.70	14,388,725.13
经营活动产生的现金流量净额	-184,120,184.12	150,607,789.20	-133,899,606.38	-73,128,112.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

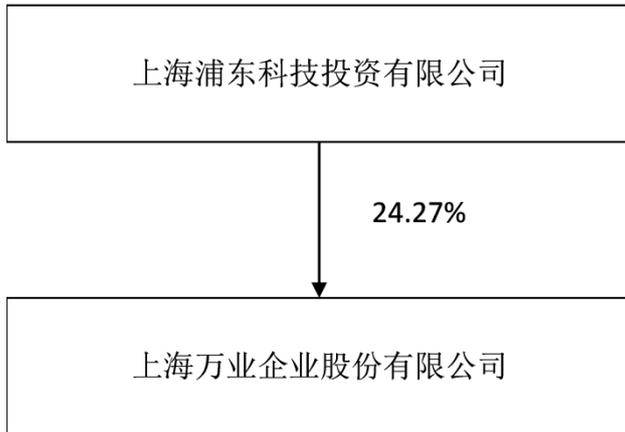
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数 (户)					56,772		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					56,777		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海浦东科技投资有限公司	-46,531,500	225,868,500	24.27	0	质押	60,000,000	境内非国有 法人
三林万业 (上海) 企业集团 有限公司	-21,148,791	74,062,021	7.96	0	质押	67,600,000	境内非国有 法人
上海国盛资本管理有限公司 —上海国盛海通股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)	46,531,500	46,531,500	5.00	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司 —银华集成电路混合型证券 投资基金	14,277,200	18,600,000	2.00	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-726,237	8,433,886	0.91	0	未知		其他
周夏真	0	8,378,000	0.90	0	未知		境内自然人
王瑞生	0	6,749,700	0.73	0	未知		境内自然人
上海万业企业股份有限公司 —第一期员工持股计划	-6,266,864	6,674,952	0.72	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司 —南方中证全指房地产交易 型开放式指数证券投资基金	1,997,961	5,056,316	0.54	0	未知		其他
基本养老保险基金一六零六	2,925,400	4,699,800	0.51	0	未知		其他

一组合							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

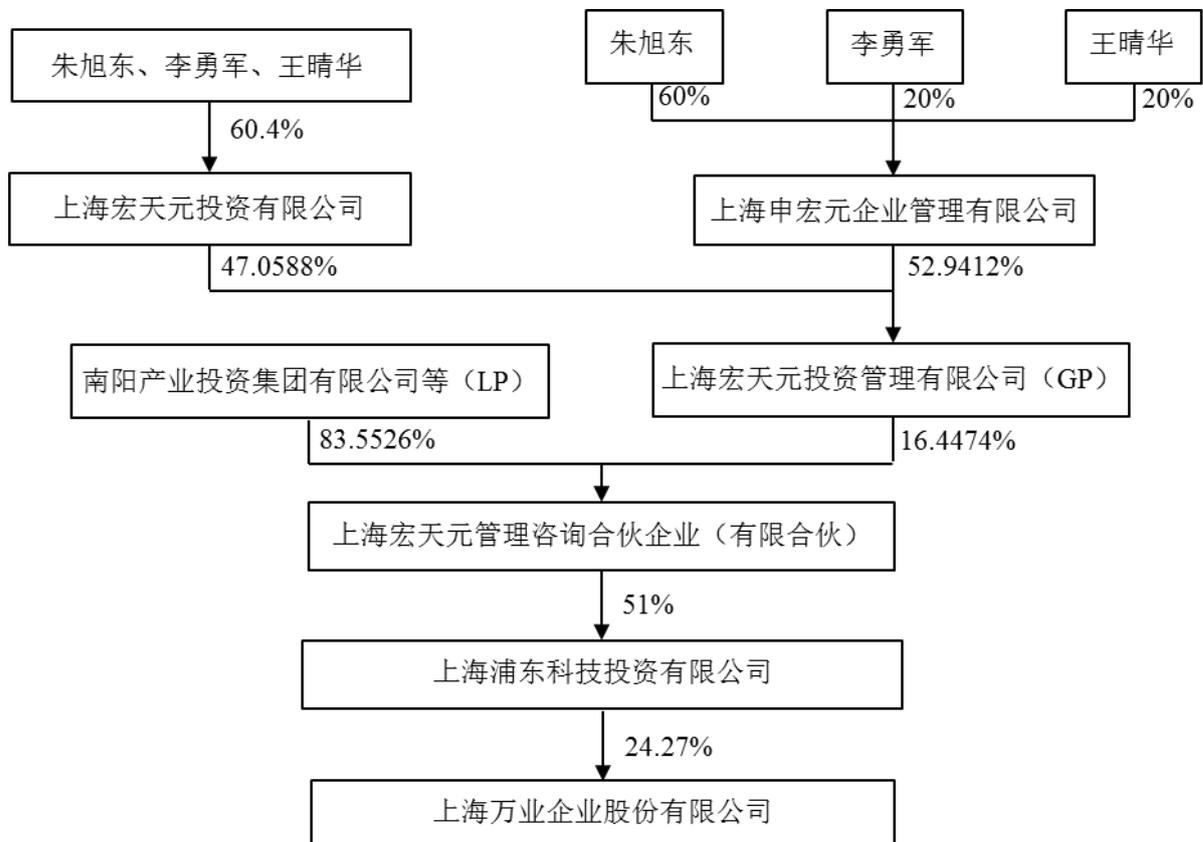
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 9.65 亿元，同比减少 16.67%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元，同比减少 64.32%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润 0.77 亿元，同比减少 75.85%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用